



kingston.com/epop

ePoP

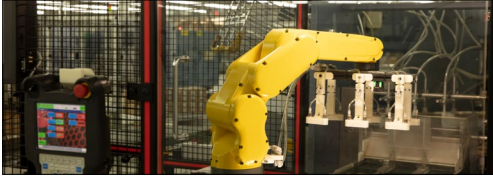
Embedded Package-on-Package Memory für Wearables

Kingstons ePoP ist eine hochintegrierte Komponente nach JEDEC-Standard, die e•MMC-(Embedded MultiMedia Card-) Speicher und LPDDR-(Low-Power Double Data Rate-) DRAM in einer Package-on-Package (PoP)-Lösung kombiniert. ePoP wird direkt auf einem kompatiblen Hostsystem-on-a-Chip (SoC) montiert, wodurch der Platz auf der Platine (PCB) reduziert und eine optimale Leistung gewährleistet wird. ePoP ist eine ideale Lösung für Anwendungen mit begrenztem Platz, wie z.B. Wearables.

WICHTIGE VORTEILE

- Durch die direkte Montage auf einem Host-SoC bietet ePoP eine ideale Lösung für Anwendungen mit kleinem Formfaktor, wie z.B. Wearables.
- Low-Power-DRAM und optimierte Speicher-Firmware reduzieren den Stromverbrauch und bieten gleichzeitig die hohe Performance, die für batteriebetriebene Wearable-Anwendungen erforderlich ist.
- Vereinfacht das Systemdesign, verkürzt sowohl die Markteinführungszeit als auch den Qualifizierungszyklus.
- Mehrere Firmware-Konfigurationen sind verfügbar, um die Anforderungen Ihrer Anwendung hinsichtlich Leistung, Stromverbrauch und Lebensdauer optimal zu erfüllen.

MARKTSEGMENTE



IoT



Wearables



AR- (Augmented Reality) / VR- (Virtual Reality) Geräte

EPOP TEILENUMMERN UND SPEZIFIKATIONEN

LPDDR4x-basierter ePoP

Artikelnummer	Speicherkapazität		Beschreibung		Verpackung (mm)	FBGA	Betriebs- temperatur
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
64EP16-M4MTB9W	64	16	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,6	144	-25 - +85°C
64EP32-M4NTB9W	64	32	5,1	LPDDR4x	8x9,5x0,65	144	-25 - +85°C

LPDDR5x-basierter ePoP

Artikelnummer	Speicherkapazität		Beschreibung		Verpackung (mm)	FBGA	Betriebs- temperatur
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM			
64EP16-M5ATB9W	64	16	5,1	LPDDR5x	8x9,5x0,58	201	-25 - +85°C
64EP32-M5BTB9G	64	32	5,1	LPDDR5x	8x9,5x0,65	201	-25 - +85°C
64EP32-M5BTB9M	64	32	5,1	LPDDR5x	8x9,5x0,7	201	-25 - +85°C

